



各位

平成23年6月8日

会社名 株式会社日立ハイテクノロジーズ  
 代表者 執行役社長 久田 眞佐男  
 本社所在地 東京都港区西新橋一丁目24番14号  
 コード番号 8036 (東証・大証第一部)  
 問い合わせ先 CSR本部コーポレート・コミュニケーション部長  
 加藤弘之 (電話: 03-3504-5138)

業績予想および配当予想の開示に関するお知らせ

平成23年4月26日公表の「平成23年3月期 決算短信」において未定としておりました平成24年3月期(平成23年4月1日～平成24年3月31日)の業績予想および配当予想を、下記の通りといたしましたのでお知らせいたします。

記

平成24年3月期第2四半期(累計)連結業績予想(平成23年4月1日～平成23年9月30日)

	売上高	営業利益	経常利益	四半期純利益	1株当たり 四半期純利益
	百万円	百万円	百万円	百万円	円 銭
前回予想(A)	—	—	—	—	—
今回予想(B)	306,000	6,000	6,000	3,600	26.17
増減額(B)－(A)	—	—	—	—	
増減率(%)	—	—	—	—	
(ご参考)前年同期実績 平成23年3月期第2四半期	335,257	13,763	14,332	9,780	71.11

平成24年3月期連結業績予想(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

	売上高	営業利益	経常利益	当期純利益	1株当たり 当期純利益
	百万円	百万円	百万円	百万円	円 銭
前回予想(A)	—	—	—	—	—
今回予想(B)	680,000	28,000	28,000	18,000	130.87
増減額(B)－(A)	—	—	—	—	
増減率(%)	—	—	—	—	
(ご参考)前期実績 平成23年3月期	653,431	27,893	29,475	17,752	129.07

[業績予想の概況]

平成23年3月11日に発生した東日本大震災により、生産設備やロジスティクス機能、サプライチェーンの一部に影響を受けましたが、大震災以降復旧に努め、現在は大震災前とほぼ同等の操業レベルに回復しております。また夏期電力供給量の使用制限につきましては、生産の前倒しに加え、休日輪番や生産エリアの集約などの節電対応を進めてまいります。

平成24年3月期の世界経済は、先進国では日本の東日本大震災の影響に加え、米国の雇用環境の改善遅れや、欧州の財政不安等の懸念材料はあるものの、穏やかな回復傾向が続くと予想されます。一方新興国については、中国をはじめアジア諸国を中心に総じて堅調な回復が見込まれます。

また、当社を取り巻く環境は、半導体製造装置市場においては、パソコン需要に減速感があるものの、スマートフォンやタブレット端末などのモバイル関連機器市場の拡大を受け、今年度も好調を維持する見込みです。FPD関連製造装置市場は、中国大陸における液晶パネル生産投資計画の遅延から、投資規模・時期が依然不透明な状況にあります。またHD関連製造市場においては、業界再編成等により、市場成長の一時的な鈍化が予想されます。科学・医用システム関連市場は、欧州および中国を中心としたアジア諸国向けの需要は堅調と予測されますが、価格競争の激化や円高の影響が懸念されます。産業・ITシステム、先端産業部材では、米国市場向け携帯電話や太陽電池関連部材等の外需は堅調が予想されるものの、車載用HDDや電子デバイス・材料等、大震災による国内市場への影響が継続することが懸念されます。以上により、当社は平成24年3月期の連結業績を上記の通り予想しております。

今後とも、ハイテク・ソリューション事業におけるグローバルトップを目指すとともに、最先端・最前線の事業創造企業として、顧客及び市場のニーズにスピーディーに対応し、業績予想の達成を目指してまいります。

(注) 上記の業績予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成されたものであります。実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。

[配当について]

平成24年3月期の配当につきましては、第2四半期末配当1株あたり10.00円、期末配当1株あたり10.00円（1株当たり年間20.00円）を目標といたします。

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
前回予想	円 銭 —	円 銭 —	円 銭 —	円 銭 —	円 銭 —
今回発表予想	—	10.00	—	10.00	20.00
前期実績 (平成23年3月期)	—	10.00	—	10.00	20.00

以上